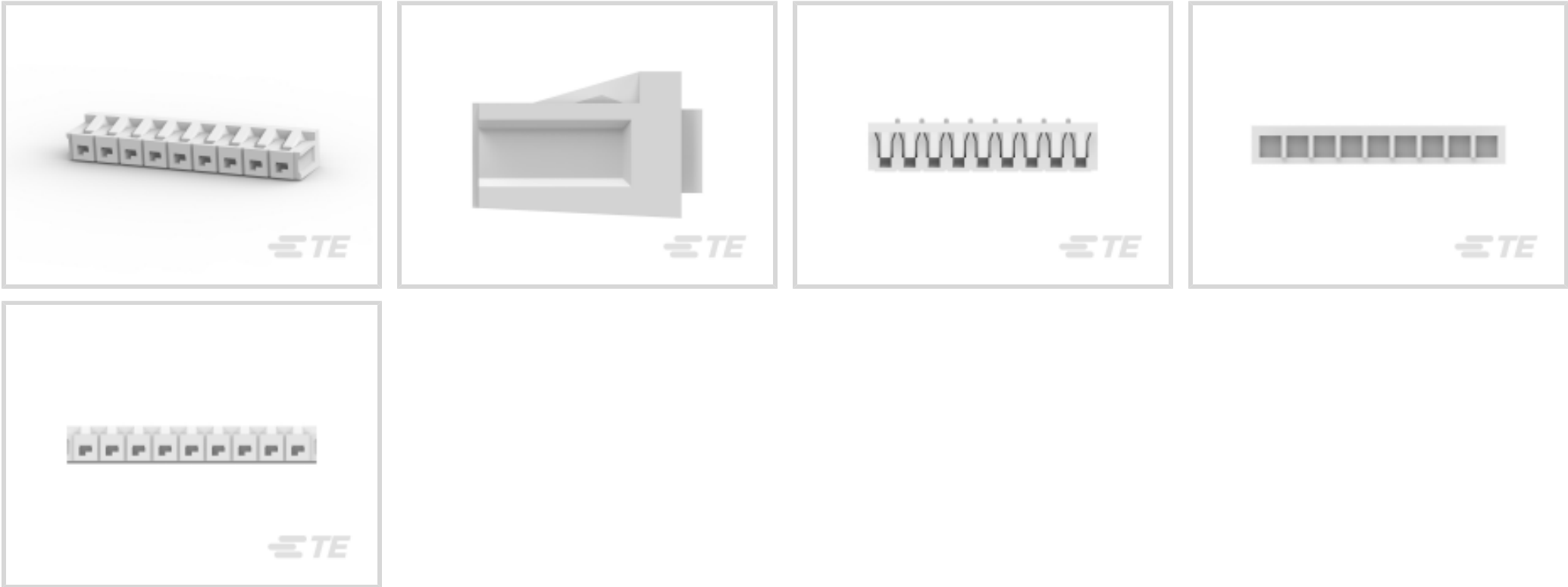




连接器 > PCB 连接器 > 板连接器



PCB 连接器类型: **PCB 安装一体式压接连接器**

PCB 安装方向: **垂直**

连接器系统: **线到板**

位数: **9**

中心线（间距）: **2.5 mm [.098 in]**

产品特性

产品类型特性

PCB 连接器类型	PCB 安装一体式压接连接器
连接器系统	线到板
连接器和端子端接到	印刷电路板, 电线和电缆

结构特性

PCB 安装方向	垂直
位数	9
与线缆类型兼容	分离式导线
行数	1

电气特征

工作电压	250 VDC
------	---------

主体特性

主要产品颜色	土黄色
--------	-----

接触件特性

--	--



端子布局	直插式
------	-----

机械附件

PCB 安装固定	不带
----------	----

壳体特性

中心线（间距）	2.5 mm[.098 in]
外壳材料	尼龙 6/6

尺寸

	.14 in
PCB 厚度（建议）	1.19 – 1.6 mm, 1.57 mm
线径	26 – 22 AWG, 30 – 22 AWG
连接器长度	23.5 mm[.925 in]

使用环境

工组温度范围	-40 – 105 °C[-40 – 221 °F]
--------	----------------------------

操作/应用

电路应用	电源和信号
------	-------

行业标准

UL 阻燃性等级	UL 94V-0
----------	----------

包装特性

封装数量	1000
封装方法	Bag

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2025年1月（247） 不含REACH SVHC
卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC



焊接工艺能力

不适合采用焊接工艺

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件

TE 产品编号 172781-3
LOW PROFILE MINI AMP-IN
(AWG#30-#26)X-TY

TE 产品编号 172781-4
LOW PROFILE MINI AMP-IN
(AWG#30-#26)Y-TY

TE 产品编号 172782-7
LOW PROFILE MINI AMP-IN

TE 产品编号 172782-5
LOW PROFILE MINI AMP-IN

客户还购买了

TE 产品编号114017-ZZ
SEALING PLUG, SIZE 12/16, WHT

TE 产品编号CAT-D48-ST273
DEUTSCH Solid Contacts

TE 产品编号DT04-2P
REC, 2P, GRY, N

TE 产品编号CAT-D487-W416
Wedgelocks: DEUTSCH DT

TE 产品编号DT06-2S
PLG, 2P, GRY, N

TE 产品编号281934-2
SINGLE WIRE SEAL

TE 产品编号CAT-AM71-CH8172
AMP SUPERSEAL 1.5MM，连接器壳体

文档

- 产品图纸
- 9P 2.5MM MINI AMP-IN HDR HSG
- 英文版本

CAD 文件



3D PDF

英文版本

下载查看

ENG_CVM_172520-9_G1.3d_stp.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_172520-9_G1.2d_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_172520-9_G1.3d_igs.zip

英文版本

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_172520-9_E.2d_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_172520-9_E.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_172520-9_E.3d_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

数据表/目录页

PRINTED CIRCUIT BOARD TERMINALS AND DISCONNECTS

英文版本

产品规格

应用规格

英文版本

应用规格

英文版本

机构认证

UL 报告

英文版本

UL 报告

英文版本